

京东方科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-044

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☐ 其他_____
参与单位名称	拾贝投资：胡建平、张剑、曾剑宇、申宗航 中信证券：程子盈、李锟
时间	2026 年 9 月 18 日
地点	京东方技术创新中心
上市公司接待人员姓名	罗文捷 证券事务代表 吴易霖 董事会秘书室工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	投资者参观了京东方技术创新中心展厅，参观后与公司进行了交流。讨论的主要内容是回答投资者提问，问答情况如下： 1、如何看待近期面板厂的涨价行为？ 答：近期，受上游原材料价格变动及全球产业链供需变化影响，公司部分关键物料采购成本持续上行，供应链成本压力持续加大。公司结合自身成本、产品及具体交易情况制定价格政策，已就部分产品的价格事项与相关客户开展沟通，具体交易价格按照双方合同约定及协商结果确定，以保障产品品质与长期稳定供货，并确保后续技术迭代与服务能力持续提升。 2、近期 OLED 行业情况？ 答：根据咨询机构预测，受 2025 年以来存储涨价影响，2026 年柔性 AMOLED 需求承压。与此同时，柔性 AMOLED 需求呈现结构性分化，LTPO、折叠等高端产品出货占比预计在高端智能手机需求成长的带动下进一步提升。此外，2026 年行业内第 8.6 代 OLED 产线陆续开

	始量产，受此催化，OLED 车载与 IT 渗透率预计均呈现提升。 3、公司布局玻璃基封装载板、钙钛矿和光互连相关领域的原因与优势是什么？ 答：围绕公司多年来积累的显示技术、玻璃基加工能力和大规模集成智造能力三大核心优势，根据“第 N 曲线”理论指导下的“屏之物联”战略，公司通过相关能力的复用，布局玻璃基封装载板、钙钛矿和 Micro LED 光互连相关应用作为未来业务发展的重要方向。钙钛矿方面，公司充分发挥微米级加工的能力，下沉布局钙钛矿；玻璃基封装载板方面，公司将技术能力升级到纳米级加工，该领域的制程、工艺环节、运营管理、上下游产业链逻辑均与公司现有能力高度协同；光互连方面，公司利用显示产业长期积累的相关技术、玻璃基加工能力及大规模智能制造能力，推进技术攻关。 4、玻璃在芯片封装中是如何应用的？ 答：玻璃在先进封装中有 3 种潜在的应用方向，分别是硅中介层的制造过程中的临时支撑（Glass Carrier）、作为封装结构基础的玻璃基载板（Glass Core Substrate）以及将玻璃作为可能的中介层（Interposer）材料。 相比之下，临时支撑玻璃并不留在封装后的芯片结构中，而玻璃作为中介层材料仍面临诸多不确定性。玻璃基载板（Glass Core Substrate）凭借更好的热稳定性、平整性等特性，解决了大尺寸高功耗芯片封装中，载板易翘曲的问题，从而提升芯片封装性能。公司布局的目标产品即为玻璃基载板（Glass Core Substrate），可匹配不同的先进封装需求。 5、公司玻璃基封装载板业务布局及进展？ 答：公司 2020 年启动玻璃基载板技术预研，2022 年投资 3.9 亿元建设玻璃基/硅基兼容的晶圆级创新实验平台，2024 年投资 9.93 亿元建设板级玻璃基封装载板试验线，并于 2025 年内完成主设备搬入调试，2026 年上半年已实现全自动化设备通线。该试验线设计产能 1,000 片/月。公司目前已实现高深宽比 TGV 开孔、深孔填铜、低应力金属布线、高层数压合、高密度布线、低应力切割等玻璃基封装载板全流程工艺拉通，拥有完备玻璃载板制造工艺能力，并已于 2025 年完成大尺寸高层数（9-2-9，20 层）玻璃基载板样品开发和送样，且现已通过 Pre-con、TCB 1000 cycles、UHAST、BHAST、HTSL、LTSL 信赖性标准测试。 6、公司目前钙钛矿项目进展？ 答：公司采用刚性/柔性/叠层组件技术路线并行开发，三大研发平
--	--

	台效率不断突破，实现了从手套箱（2.5*2.5cm）到实验线（30*30cm）再到中试线（120*240cm）三大平台全工艺流程拉齐，手套箱效率记录达 27.94%，实验线 21.39%，中试线 20.11%，柔性 16.6%。 认证方面，京东方光能已获多项国内外权威机构产品认证，标志着公司钙钛矿产品的安全性、可靠性、环保性已达到国际公认标准。2026 年 4 月，京东方光能钙钛矿户外实证基地在京东方第 10.5 代 TFT-LCD 生产线园区正式投入运行，规划总装机规模 200kW，涵盖自行生产的刚性、柔性及叠层组件，并同步引入碲化镉、晶硅（BC、TOPCon、HJT）等主流技术路线组件对比验证，构建多技术路线同台实证平台。公司计划今年下半年在黑龙江漠河（极寒）、新疆吐鲁番（干热沙尘 50 度以上）和宁夏银川（高辐射、大温差）开展极致条件实证测试。 7、公司目前光互连项目进展？ 答：公司已成立 Micro LED 光互连系统及玻璃载板 CPO 技术攻关项目组，和生态伙伴进行前瞻技术预研，加快技术攻关。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单	无
日期	2026 年 9 月 18 日